

证券代码：300657

证券简称：弘信电子

公告编号：2023-70

厦门弘信电子科技集团股份有限公司

2023 年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，公司董事会编制了截至 2023 年 6 月 30 日的募集资金存放与使用情况的专项报告，具体内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

1、2019年非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）签发的《关于核准厦门弘信电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1182号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股 30,313,428 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 23.83 元/股，共计募资资金人民币 722,368,989.24 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 17,197,662.68 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 705,171,326.56 元。该募集资金已于 2019 年 8 月 27 日全部到位，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了“致同验字（2019）第 350ZA0031 号”验资报告。

2、2020年向不特定对象发行可转换公司债券

经中国证监会签发的《关于同意厦门弘信电子科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]1955 号）同意注册，公司向不特定对象发行 570.00 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，共计募资资金人民币 570,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 7,781,182.22

元(不含税)后,募集资金净额为人民币 562,218,817.78 元。该募集资金已于 2020 年 10 月 21 日全部到位,经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具“容诚验字[2020]361Z0084 号”验资报告。

3、2022年向特定对象发行股份募集配套资金

经中国证监会签发的《关于同意厦门弘信电子科技集团股份有限公司向巫少峰等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可[2022]1097 号)同意注册,公司向特定对象发行人民币普通股 18,564,102 股,发行价格为人民币 9.75 元/股,共计募集资金人民币 180,999,994.50 元,扣除发行费用人民币 10,736,121.39 元(不含税)后,募集资金净额为人民币 170,263,873.11 元。该募集资金已于 2022 年 7 月 11 日全部到位,经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具了“容诚验字[2022]361Z0053 号”验资报告。

(二) 2023 年上半年度募集资金使用及结余情况

1、2019年非公开发行股票

截至 2023 年 6 月 30 日公司累计使用募集资金 72,175.34 万元,其中本期直接投入募集资金项目 3,229.54 万元(其中含项目结余补流 2,757.23 万元)。募集资金专户余额为 0 元。

2、2020年向不特定对象发行可转换公司

截至 2023 年 6 月 30 日公司累计使用募集资金 56,961.70 万元,其中本期直接投入募集资金项目 1,691.83 万元(其中含项目结余补流 1,691.83 万元)。募集资金专户余额为 4.25 万元。¹

3、2022年向特定对象发行股份募集配套资金使用及结余情况

截至 2023 年 6 月 30 日公司累计使用募集资金 17,011.08 万元,其中本期直接投入募集资金项目 0 元,募集资金专户余额为 29.24 万元。

二、募集资金的存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《厦门弘信电子科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。该《管理办法》经本公司董事会第二届第五次会议审议通过，并业经公司2016年度股东大会表决通过。

2020年8月，公司召开第三届董事会第十三次会议，并经公司2020年第三次临时股东大会表决通过，对《管理办法》进行了修订。

2023年8月，公司召开第四届董事会第十五次会议审议通过了修订后的《管理办法》。前述修订后的《管理办法》尚待公司2023年第三次临时股东大会审议通过。

根据《管理办法》并结合经营需要，公司从2017年5月起对历次募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构/财务顾问等签订了募集资金三方/四方监管协议，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

（二）募集资金专户存储情况

1、2019年度非公开发行股票

截至2023年6月30日，2019年非公开发行股票募集资金存放情况如下：

单位：人民币万元

银行名称	银行帐号	初始存放金额	截至2023年6月30日余额
中国农业银行股份有限公司厦门湖里支行	40340001040052331	-	-
兴业银行股份有限公司厦门分行	129680100100931955	70,752.62	-
招商银行股份有限公司厦门翔安支行	592900024510303	-	-
中国工商银行股份有限公司厦门翔安支行	4100028629200087573	-	-
中国进出口银行厦门分行	221000010000023589	-	-

银行名称	银行帐号	初始存放金额	截至 2023 年 6 月 30 日余额
	1		
合计	-	70,752.62	-

注 1: 募集资金到账兴业银行后, 再逐一转其他募集资金专户。

注 2: 初始存放金额与募集资金净额的差额为 235.49 万元, 系尚未支付的发行费用。

2、2020 年向不特定对象发行可转换公司债券

截至 2023 年 6 月 30 日, 公司 2020 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存放情况如下:

单位: 人民币万元

银行名称	银行帐号	初始存放金额	截至 2023 年 6 月 30 日余额
兴业银行股份有限公司厦门分行	129680100101028519	56,523.00	-
平安银行厦门分行营业部	15585756760083	-	-
中国进口银行厦门分行	2210000100000228319	-	4.25
招商银行股份有限公司厦门翔安支行	592900024510603	-	-
中国进口银行厦门分行	2210000100000231113	-	-
合计	-	56,523.00	4.25

注 1: 募集资金到账兴业银行后, 再逐一转其他募集资金专户。

注 2: 初始存放金额与募集资金净额的差额为 301.12 万元, 系尚未支付的发行费用。

3、2022 年向特定对象发行股份募集配套资金

截至 2023 年 6 月 30 日, 公司 2022 年向特定对象发行股份募集配套资金的募集资金存放情况如下:

单位: 人民币万元

银行名称	银行帐号	初始存放金额	截至 2023 年 6 月 30 日余额
兴业银行股份有限公司厦门湖滨支行	129420100100312365	17,200.00	29.24

注: 初始存放金额与募集资金净额的差额为 173.61 万元, 系尚未支付的发行费用。

三、2023 年上半年度募集资金的实际使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日, 公司募集资金投资项目资金使用情况详见“附件 1: 募集资金使用情况对照表”。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况“详见附表 2：变更募集资金投资项目情况表”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，本报告期不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表 1：募集资金使用情况对照表

附表 2：变更募集资金投资项目情况表

厦门弘信电子科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日

附表 1:

2023 年上半年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		143,765.40				本年度投入募集资金总额	4,921.37			
报告期内变更用途的募集资金总额		6,134.93				已累计投入募集资金总额	146,148.12			
累计变更用途的募集资金总额		16,757.03								
累计变更用途的募集资金总额比例		11.66%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
2019 年非公开发行股票										
1.翔安工厂挠性印制电路板技改及扩产项目	是	24,792.95	23,734.63		24,244.29	102.15%	2020年7月1日	-2,873.26	否	否
2.电子元器件表面贴装智能化生产线建设项目	是	17,971.59	9,009.44		9,787.45	108.64%	2020年12月31日	不适用【注1】	不适用	否
3.补充流动资金	否	20,500.04	26,136.46	2,757.23	26,170.13	100.13%	不适用	不适用	不适用	否
4.FPC 前瞻性技术研发项目	是	7,252.55	7,188.36		7,380.64	102.67%	2021年6月30日	不适用	不适用	否

5.江西软硬结合板二期项目	是	—	4,448.24	472.31	4,592.83	103.25%	2022年12月31日	-2,417.55	不适用	否
承诺投资项目小计	—	70,517.13	70,517.13	3,229.54	72,175.34		—	-5,290.81	—	—
2020年向不特定特定对象发行可转换公司债券										
6.荆门弘信柔性电子智能制造产业园一期工程	是	29,590.46	27,352.06		27,968.75	102.25%	2021年11月	-4,101.59	不适用	否
7.江西弘信柔性电子科技有限公司软硬结合板建设项目	是	9,863.49	8,181.36		8,276.12	101.16%	2021年12月	-4,356.31	不适用	否
8.偿还银行贷款	是	16,767.93	16,767.85	—	16,796.03	100.17%	不适用	不适用	不适用	否
9. 补充流动资金	不适用	不适用	3,920.61	1,691.83	3,920.80	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	—	56,221.88	56,221.88	1,691.83	56,961.70		—	-8,457.90	—	—
2022年向特定对象										
10、向巫少峰等发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目中支付本次交易的现金对价	否	9,251.39	9,251.39		9,236.08	99.83%	不适用	不适用	不适用	否
11、偿还上市公司银行贷款项目	否	7,775.00	7,775.00		7,775.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	—	17,026.39	17,026.39		17,011.08	-	—	—	—	—

承诺投资项目合计	—	143,765.40	143,765.40	4,921.37	14,6148.12	-	—	-13,748.71	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>①翔安工厂挠性印制电路板技改及扩产项目：受下游市场需求放缓影响，产能释放进度减缓，尚未完全释放。②江西软硬结合板二期项目及江西弘信柔性电子科技有限公司软硬结合板建设项目：实现效益低于承诺效益原因系受市场影响所致。③SMT为FPC生产过程中的一道工序，并不直接产生收入，本项目效益主要体现在降低生产成本、提升公司对客户“一站式”服务能力和保证产品质量方面。④FPC前瞻性技术研发项目、补充流动资金、偿还银行贷款不适用上述效益情况说明。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>公司于2020年4月9日召开第三届董事会第九次会议及2020年5月6日召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，公司将募投项目中“电子元器件表面贴装智能化生产线建设项目”实施地点从“厦门市翔安区火炬高新区翔安产业区翔岳路23号A-14栋”变更至“厦门市翔安区火炬高新区翔安产业区春风西路4号弘信移动互联创业园2号楼第2层、第3层”。公司监事会、独立董事、保荐机构发表了同意意见。</p>									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>2019年非公开发行股票：2019年9月19日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于厦门弘信电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》（致同专字（2019）第350ZA0286号）。根据该报告，截止2019年9月10日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为5,894.70万元。公司于2019年9月19日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金5,894.70万元置换预先投入募投项目的自筹资金。2019年9月20日，国信证券股份有限公司发表了《关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金之专项核查意见》，同意本公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项。2019年12月31日，公司已完成了上述置换。</p> <p>2020年向不特定对象发行可转换债券：2020年11月11日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于厦门弘信电子科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2020]361Z0614号）。根据该报告，截止2020年11月5日，公司使用自筹资金预先投入募投项目的金额合计为人民币9,385.14万元。公司于2020年11月14日召开的第三届董事会第十七</p>									

	<p>次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币 9,385.14 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。2020 年 11 月 15 日，国信证券股份有限公司发表了《关于厦门弘信电子科技集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》，同意本公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项。截至 2021 年 3 月 31 日，公司已完成了上述置换。</p> <p>2022 年向特定对象发行股份募集配套资金：2022 年 7 月 18 日，根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于厦门弘信电子科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2022]361Z0435 号）。根据该报告，截至 2022 年 7 月 18 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的合计金额为 1,399.50 万元。公司于 2022 年 7 月 25 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用之自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币 1,399.5 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。2022 年 7 月 26 日，国信证券股份有限公司发表了《关于厦门弘信电子科技集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》，同意本公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项。截至 2022 年 7 月 31 日，公司已完成了上述置换。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	截至 2023 年 6 月 30 日，2019 年非公开发行股票募集资金专户余额 0 元，2020 年向不特定对象发行可转换债券募集资金专户余额 4.25 万元。2022 年向特定对象发行股份募集配套资金专户余额 29.20 万元。2023 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第十二次会议，经过审议，公司全部募集资金投资项目均已终止或实施完毕。前述项目终止或结项后结余用于永久性补充流动资金的款项尚未自募集资金专户中转出，公司将于 2023 年 9 月 30 日前完成前述资金转出并及时注销募集资金专户。
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

注 1：SMT 为 FPC 生产过程中的一道工序，并不直接产生收入，本项目效益主要体现在降低生产成本、提升公司对客户“一站式”服务能力和保证产品质量方面，因此实现的效益不适用。

附表 2:

变更募集资金投资项目的资金使用情况对照表

单位: 万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
江西软硬结合板二期项目	电子元器件表面贴装智能化生产线建设项目	4,448.24	472.31	4,592.83	103.25%	2022年12月31日	-2,417.55	不适用	否
2019年定向增发-补充流动资金	2019年定向增发项目	26,136.46	2,757.23	26,170.13	100.13%			不适用	否
2020年可转债-补充流动资金	2020年可转债项目	3,920.61	1,691.83	3,920.80	100.00%			不适用	否
合计	-	34,505.31	4,921.37	34,683.76			-2,417.55		
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			1、2019年非公开发行股票 (1)公司于2020年4月9日召开第三届董事会第九次会议及2020年5月6日召开2019年年度股东						

	<p>大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，公司将募投项目中“电子元器件表面贴装智能化生产线建设项目”实施地点从“厦门市翔安区火炬高新区翔安产业区翔岳路 23 号 A-14 栋”变更至“厦门市翔安区火炬高新区翔安产业区春风西路 4 号弘信移动互联创业园 2 号楼第 2 层、第 3 层”。</p> <p>(2) 公司于 2021 年 1 月 13 日召开第三届董事会第二十次会议及 2021 年 2 月 1 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，公司将“电子元器件表面贴装智能化生产线建设项目”的募集资金 7,200.00 万元变更用于新项目“江西弘信柔性电子科技有限公司软硬结合板建设二期项目”。</p> <p>(3) 公司于 2023 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十二次会议及 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意终止 2019 年非公开发行股票募集资金投资项目“江西弘信柔性电子科技有限公司软硬结合板建设二期项目”，并将剩余募集资金永久性补充流动资金。</p> <p>2、2020 年向不特定对象发行可转换公司债券</p> <p>公司于 2023 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十二次会议及 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意终止 2020 年向不特定对象发行可转换债券募集资金投资项目“江西弘信柔性电子科技有限公司软硬结合板建设项目”，并将剩余募集资金永久性补充流动资金。</p> <p>3、2022 年向特定对象发行股份募集配套资金</p> <p>公司 2022 年向特定对象发行股份募集配套资金不存在募投项目变更的情况。</p>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	“江西软硬结合板二期项目”及“江西弘信柔性电子科技有限公司软硬结合板建设项目”：实现效益低于承诺效益原因系受市场影响所致。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用